

## EDITORIAL

Umverpackung von Hochtemperatur-Elektronikbaugruppen	2537
--	------

## VERBÄNDE

 <b>FBDi</b> - Informationen	2577
---	------

<b>F E D</b> - Informationen	2589
------------------------------	------

<b>ZVEI</b> - Informationen	2609
-----------------------------	------

 <b>iMAPS</b> - Mitteilungen	2643
---	------

 <b>3-D MID</b> - Informationen	2665
--	------

<b>DVS</b> - Mitteilungen	2684
---------------------------	------

## AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes	2540
Neue Normen	2559
Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung	2560
Productronica – Impressionen	2562

## BAUELEMENTE

Original oder Fälschung?	2566
Verbindungslösungen für die industrielle Netzwerkstruktur einer klugen Fabrik	2568
Distrelec vertreibt neue Alu-Elkos von Panasonic	2570
Neue effizientere und kleinerer DC/DC-Power-Module	2571
Neue Leistungs-MOSFETs für industrielle Applikationen und Fahrzeuganwendungen	2574
Mentor Graphics Hypervisor: Mehrere Betriebssysteme auf einer ECU	2575
SSDs zur anwendungsgerechten Auswahl	2576

## DESIGN

Branchenweit erste App für das PCB-Layout	2579
---	------

## DESIGN

DesignSpark Mechanical bietet vielen Ingenieuren 3D-Design-Einsatzmöglichkeiten	2581
Fertigung von biegsamen Displays und krummen Akkus	2584
Altium Designer 14 bringt neue Qualität in das Leiterplattendesign	2587
Simulationssoftware – Modellerstellung, Interface und Solver als Entwicklungsschwerpunkt	2588

## LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H.J. Friedrichkeit) Was erwartet uns 2014?	2595
APL Oberflächentechnik erweitert Dienstleistungsangebot	2598
Intelligente Prozesse reduzieren Betriebskosten in der Leiterplattenproduktion	2600
Paradigmenwechsel im Bereich der Lötstopplack-Belichtung	2604
Gelungene Eröffnungsfeier mit Branchentalk	2606

## BAUGRUPPEN & SYSTEME

GL-Schablonendrucker mit innovativen Aspekten	2616
Produktionsnahe Zwischenlager für die SMD-Fertigung	2618
Innovative Drucklösungen für die Leiterplattenfertigung	2620
Flexible SMT-Lösungen für manuelle Vor- / Nacharbeiten	2622
Elektroniklot SN100C nun auch von der Felder GmbH	2624
Moderne wasserbasierende Reinigung von Hochfrequenz-Baugruppen	2625
Neue Dispenser für die Elektronikmontage	2626
Die- und Flip-chip-Bonder	2628
Heißenieten – Vorteile einer neuen Konstruktionsrichtlinie	2630
Batch-Reinigungssystem als Alternative zu In-Line-Anlagen	2634
Solides Marktwachstum für elektronische Komponenten	2635
Erweitertes Leistungsspektrum im Bereich von Leiterplatten-Layout und Schaltungsentwicklung	2637
Alles im Lot – Elsolid nimmt neues Werk in Betrieb	2639

## ANALYTIK & TEST

Kooperationsforum HF-Entwicklung	2653
Marktlücken bei Table-top- und Inline-Inspektion geschlossen	2656
Testen von elektronischen Flachbaugruppen in der Praxis	2658
Optimale Inspektion von THT-Baugruppen	2661
Neuer GRS550 Flying Prober von Polar Instruments	2664
Lötbarkeitstester arbeitet mit Lotpaste und Temperaturprofil	2664

## FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Hochzuverlässiger Haftvermittler zwischen Mold-Komponenten und Silberoberflächen	2669
Patente	2678

## FORUM

Microelectronics Europe – SEMICON Europa2013 und Plast Electronics2013	2686
Lean Production im Prozess	2700
Qualitätsmanagement – wie macht man alles neu und erhält dabei Altbewährtes	2703

Schüler präsentieren eigene Innovationen	2706
Weniger Platzbedarf und höhere Bildqualität im Ultraschall-Equipment	2708
Intelligenter Super-Kampfanzug mit viel Elektronik geplant	2710
Kolumne – Anders gesehen: Haben Sie die Nase auch voll?	2712
PLUS-Firmenverzeichnis	2714
Firmenindex	2738
Inserentenindex	2740
Stellenmarkt und Kleinanzeigen	2741
Anzeigenformate und Preise	2742
Impressum	2743
<b>Produkt des Monats</b>	2744

**Titelbild:** EP/EPAG weist im Vergleich zu Endoberflächen wie ENIG, ENEPIG oder elektrolytisch Nickel/Gold große Vorteile bezüglich Kosten, Bondbarkeit, Anzahl der Prozess-Schritte, geringerem Einfluss auf Stopplacke und Basismaterialien auf. Die EPAG-Oberfläche ist mittels verschiedenster Drahtbondtechniken bondbar. Die Markteinführung von EPAG erfolgt im 1Q/2014.  
Weitere Informationen: [www.apl-ssc.com](http://www.apl-ssc.com)

Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente  
Distribution e.V.,  
Tel. +49/8165/670233,  
[w.ziehfuss@fbdi.de](mailto:w.ziehfuss@fbdi.de), [www.fbdi.de](http://www.fbdi.de)



Fachverband Electronic  
Components and Systems  
Tel. +49/69/6302-276 bzw. -251,  
[zvei-be@zvei.org](mailto:zvei-be@zvei.org), [www.zvei.org](http://www.zvei.org)



Fachverband Elektronik-Design e.V.,  
Tel. +49/30/8349059,  
[info@fed.de](mailto:info@fed.de), [www.fed.de](http://www.fed.de)



Fachverband PCB  
and Electronic Systems  
Tel. +49/69/6302-437,  
[PCB-ES@zvei.org](mailto:PCB-ES@zvei.org), [www.zvei.org](http://www.zvei.org)



INTERNATIONAL  
MICROELECTRONICS  
AND PACKAGING SOCIETY –  
Deutschland e.V.,  
Tel. +49/3677/69-3381,  
[martin.schneider-ramelow@imaps.de](mailto:martin.schneider-ramelow@imaps.de)  
[www.imaps.de](http://www.imaps.de)



Forschungsvereinigung  
Räumliche Elektronische  
Baugruppen 3-D MID e.V.  
Tel. +49/911/5302-9100,  
[info@3dmid.de](mailto:info@3dmid.de), [www.3dmid.de](http://www.3dmid.de)



European Interconnect  
Technology Initiative e.V.  
Tel. +49/69/6302-281,  
[eiti@zvei.org](mailto:eiti@zvei.org), [www.eiti.org](http://www.eiti.org)



DVS – Deutscher Verband  
für Schweißen und  
verwandte Verfahren e.V.  
Tel. +49/211/1591-0,  
[michael.weinreich@dvs-hg.de](mailto:michael.weinreich@dvs-hg.de),  
[www.dvs-ev.de](http://www.dvs-ev.de)

Die offiziellen Verbandsmitteilungen an Mitglieder und Fachwelt erscheinen monatlich in der PLUS.